

证券代码：301200

证券简称：大族数控

深圳市大族数控科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	大成基金（7月3日） 中金公司（7月3日） 华福证券（7月3日） 长江资管（7月4日） 中金资管（7月4日）
时间	2024年7月3日-7月4日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：杨朝辉 副总经理、财务总监兼董事会秘书：周小东 证券事务代表：周鸳鸯
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司经营情况</p> <p>随着消费电子终端库存逐步消化，加上新能源汽车电子技术升级及 AI 服务器需求增加，下游客户的资本支出增长显著，拉动对 PCB 专用设备的需求，公司 2024 年第一季度实现营业收入 75,052.04 万元，同比增长 149.08%，归属于上市公司股东的净利润 6,360.12 万元，同比增长 21.49%。</p> <p>二、公司所处行业情况及行业地位</p> <p>PCB 是电子产品之母，是电子信息产业的基础产业，伴随着 AI 产业链、卫星通讯、汽车无人驾驶等新兴应用的兴起，行业长</p>

期来看整体延续增长态势；根据 PrismaMark 预测，2024 年全球 PCB 产业重归成长通道，预计全年增长幅度可达 5%，并对行业的中长期维持积极展望，预估 2023-2028 年 PCB 行业营收复合增长率为 5.4%，其中 IC 封装基板、18 层以上多层板、HDI 保持较高的增速，但受全球经济波动的影响，PCB 产业依然存在投资支出年度不平均的情况，但整体规模持续保持正向增长态势。

公司深耕 PCB 市场 20 余年，通过不断创新业务发展模式，形成了技术、产品、应用场景、供应链、客户的多维协同，创造性地发挥协同优势，持续保持市场领先地位。多年来屡次荣获行业知名上市企业“金牌供应商”、“优秀供应商”、“最佳设备合作伙伴”等荣誉奖项，与行业众多龙头客户形成良好的战略合作关系，成为客户端新场景、新项目研发的优先合作伙伴。

三、HDI 市场及 IC 封装基板领域进展

面对 HDI 市场应用场景日渐增加，其技术难度不断提升，如叠层数增加、盲孔孔径减小及密度增加、高频高速材料的应用等，公司推出诸多技术升级产品，包含高转速主轴机械钻孔机、四光束 CO₂ 激光钻孔机、UV+CO₂ 复合激光钻孔机、L/S 12/12μm 高解析度激光直接成像机、CCD 六轴独立控制机械成型机、定位精度±5μm 高精专用测试机等，并针对不同需求提供个性化的解决方案，已在国内多家知名 HDI 企业获得批量订单，产品市场占有率进一步攀升。

公司一直以来紧紧围绕国内封装基板龙头客户的需求进行产品研发，推出的高转速载板专用机械钻孔机获得国内多家龙头客户的认证，可满足 BT 载板及 FC-BGA 载板小孔径的高精度加工；创新运用新型激光技术，开发出用于玻璃基在内先进封装基板的加工方案，包括极小直径钻孔、盲槽及内埋高精度元器件锣槽等工艺的应用，广泛获得国内外封装基板厂商的技术认证及顶级终端客户的认可；研发的封装基板高精专用测试及 FC-BGA 单片测试设备，具备对标龙头企业 Nidec-Read 主流机型的能力。

四、海外市场情况

PCB 制造企业海外布局进展加速，特别是泰国、越南等东南亚地区诸多项目进入设备评估阶段，公司积极拓展海外市场，推进海外公司设立，建立本土化的运营团队，及时满足客户的购机或技术支援需求。目前已与从中国大陆出海到东南亚国家的多家 PCB 企

	<p>业达成合作意向，随着下游客户东南亚项目的陆续落地，公司海外市场的销售额有望显著增长。</p> <p style="text-align: center;">五、公司的发展战略规划</p> <p>一方面，公司将持续深挖多层板市场价值，加大创新研发力度，打造超越客户预期的优化解决方案，并通过产业链上下游价值发现机制，不断拓宽公司产品矩阵，持续放大公司在该市场的价值；另一方面，公司聚焦市场增速快、技术门槛更高的 HDI 板、IC 封装基板、挠性板及刚挠结合板等领域，发挥多产品、多场景的协同优势，研发适应不同细分市场需求的、具有市场竞争力的覆盖 PCB 生产全流程的智能制造解决方案，不仅要从产品性能层面打破国外的技术垄断，更要从 PCB 全流程智造的维度实现对国外技术的赶超。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 7 月 4 日